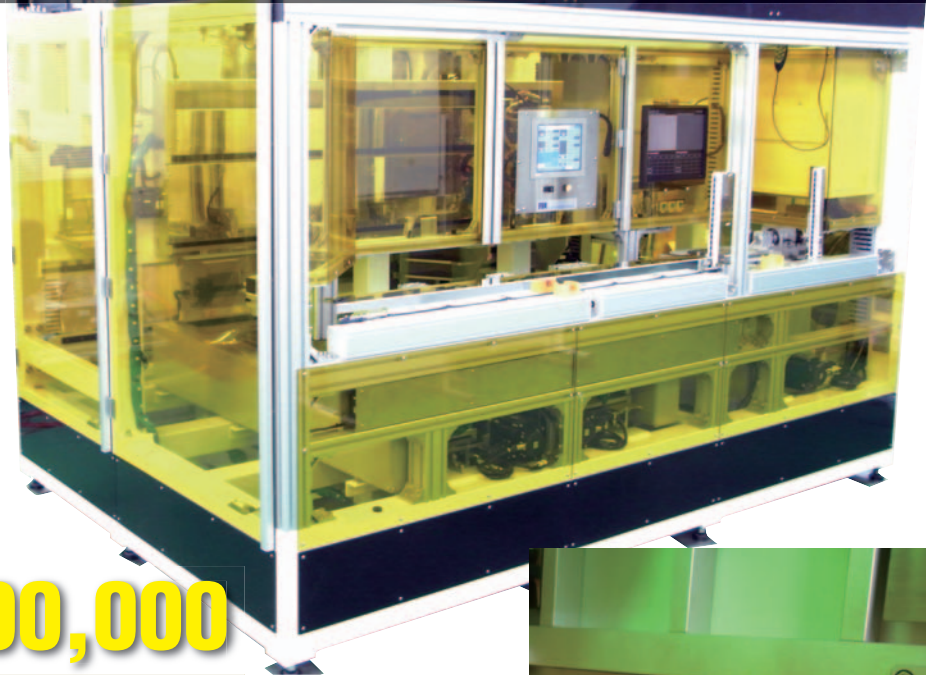


大気Bend方式による タッチパネル貼合せ装置



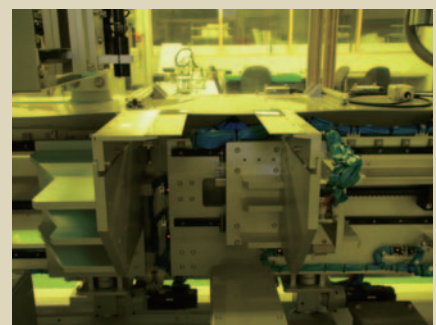
(参考価格)

¥40,000,000

スマートフォンやタブレット端末の製造工程では、静電容量式タッチパネルと前面板との全面貼り合わせが必須となっています。その工程においてFUKでは、前面板を反らせながら貼せる大気Bend方式を新たに開発することで、大気圧環境下でのガラス同士の貼合せを実現しました。前面板の両端をピローで把持して動かないように規制を掛けた状態で、貼り終わり側のピローを貼り合わせ高さよりも高く上げた姿勢でローラーの高さ制御とステージの移動速度及び貼り終わり側のピローの高さを制御して先付きしないように端から貼り合わせていきます。この技術により従来装置に比べて省エネルギー性に優れた高効率かつ高精度な装置を実現しました。

ここが
ポイント!

- 常圧環境下でカバーガラスを機械的に若干しならせてパネルに貼り合わせる、大気Bend方式の装置開発
- 特定ものづくり基盤技術:位置決めに係る技術



[企業PROFILE]

株式会社FUK

代表取締役社長 植村 光生

奈良県御所市室1186-12

Tel : 0745-63-0101 Fax : 0745-63-0023

<http://fuk.co.jp>

企業からのひとこと!

大気Bend貼合せ装置は、従来の真空方式に対して、材料へのストレスが少ないプロセスであり、タッチパネル製造の変革を目指します。この新技術により、スマートフォン等の商品信頼性と低コスト化に寄与します。